

環境ビジネスに対する複合材料の貢献

(株)FJコンポジット 代表取締役 津島栄樹

第38回 ナノビズマッチ(NBM) 講演会

日時 : 2009年12月2日 13:30~17:30

会場 : 日本貿易振興機構(ジェトロ)5階会議室

FJコンポジットの事業内容

半導体用ヒートシンク (Cu/Moクラッド材)

通信デバイス用 メタルベース (携帯電話基地局向け)

LED用メタルウェファァ (サファイア代替材料)

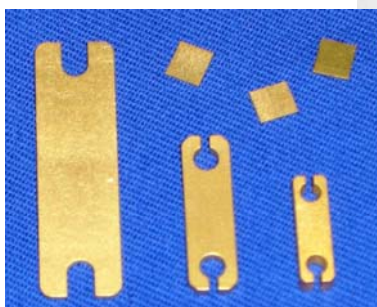
周波数変換素子 冷却基板 (セラミックス接合品)

燃料電池セパレータ材 (炭素粉末/樹脂複合材)

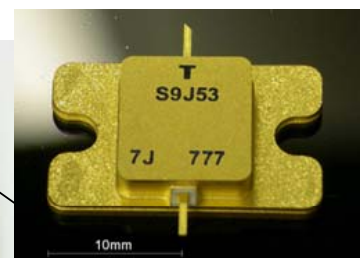
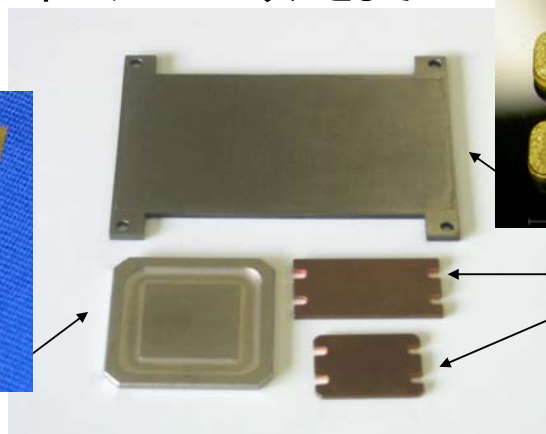
PEFC固体高分子型燃料電池用セパレータ板

(4)スーパーCMC(多層Cu/Mo積層材)の用途例

携帯電話基地局用デバイスのベースメタルとして採用されている。



特許取得済

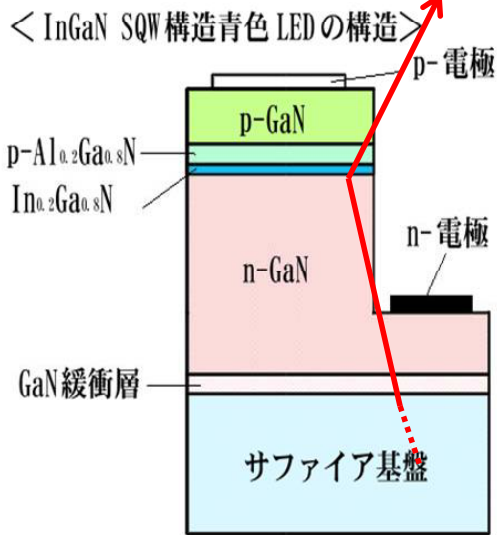


(2)

- (1) **Carbon/Al** 複合材料(Niメッキ品) CPU リッド用
- (2) **Multi Cu-Moクラッド板** 通信素子(FET)用基板
「高熱伝導と低熱膨張を実現」

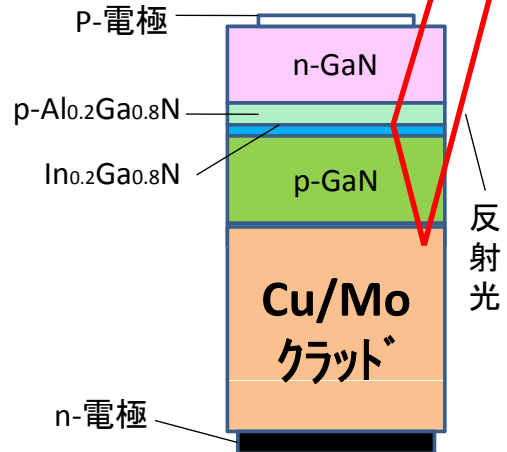
高輝度LEDにおけるメタルウェファァーの効果

従来構造のLED



CMC使用のLED

発光効率 アップ
小型化
高放熱性



FJC製造の燃料電池セパレータ板

燃料電池セパレータ需要

1台の車に400枚のセパレータが必要となる。

FJCの特徴

高速製造技術 6秒/枚(1/100)

低コスト化 100円/枚

国内外のユーザーに
サンプル配布中

